Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники



Направления научных и прикладных исследований

- Компьютерное проектирование технологии/прибора/схемы/системы
- Квантово-динамическое и молекулярно-динамическое моделирование свойств перспективных материалов и структур
- Моделирование и оптимизация технологических процессов (микробиология)
- Информационные и интернет технологии в образовании и научных исследованиях

Используемые программные средства

 Silvaco, Cadence
 VASP, HyperChem, NwChem, Ecce
 Python (PyQT, NumPy, SciPy), Scilab, Mathematica

Php, MySQL, JavaScript, SCORM

Расчеты из первых принципов (ab-initio)

Использование фундаментальных законов физики

Набор "принятых" приближений для численного решения соответствующих уравнений

Отсутствие эмпирических приближений

Моделирование атомных конфигураций

Основные подходы:

моделируемый объект (твердое тело) представляется как механическая система – методы молекулярной динамики и молекулярной механики;

моделируемый объект твердое тело представляется как квантовохимическая система – методы квантовой химии.



Расчет функционала плотности (DFT)

 \square

Точно прогнозируемые структурные и динамические свойства материала



Программные средства моделирования физических свойств кристаллов из первых принципов



Области применения:

- квантовые вычисления
- квантовый детектор



Фото-изомеризация ретинала

Экспериментальные исследования показали: внесение в питательную среду порошкообразного пористого кремния в концентрациях 0,001-0,1% приводит к увеличению концентрации клеток бактерий на 32-56% и спор – на 38-88%, не оказывая влияния на их антимикробную активность; при использовании пористых материалов в качестве носителей для посевного материала, концентрация спор полученного указанным способом биопрепарата составляет 1,3×10⁹/мл, что на 32% выше, чем с обычным посевным материалом.



Бактерии *Bacillus subtilis* на поверхности пористого кремния (изображение получено ACM)

Построена сетчатая структура однослойного муреина 4×4 (16 молекул пептидогликана). При расчете минимума энергии слой изогнулся под небольшим углом, что свидетельствует о пластичности слоя.



- Рассмотрены два механизма образования новой связи кислорода с подложкой: С-О-Н-Si и C-O-Si, причем в первом случае вероятно образование водородной связи;
- Моделирование в программе NWChem осуществлялось с использованием метода SCF.
- Для атомов, участвующих во взаимодействиях использовался базис 6-31G*, для остальных – 3-21G.



- Результаты вычислений показали, что при взаимодействии клеточной фрагмента стенки с поверхностью кремния по механизму C-O-Si, как и предсказывалось, может образовываться ковалентная связь Si-O, длиной ~ 0.17 нм;
- Взаимодействие по механизму C-O-H-Si не приводит ни к образованию ковалентной связи, ни к образованию водородной связи;
- Из полученных результатов можно сделать вывод, что бактерия будет иммобилизоваться посредством образования химических связей на кремниевой подложке, поверхность которой очищена от водорода.





2. Система SiO₂ на углеродной нанотрубке (УНТ) как элемент нано МОПтранзистора



Система SiO₂ на углеродной нанотрубке (УНТ) как элемент нано МОП-транзистора



Взаимодействие между углеродной нанотрубкой и монослоем SiO₂



Облако колец Si₆O₁₈ вокруг углеродной нанотрубки

Цепочки Si_nO_{3n} и углеродная нанотрубка

Моделирование электронных и магнитных свойств ZnO



- Наностержни
- Сферические наночастицы
- Пластинки

- Тетраподы
- Цветкообразные структуры
- Гексогональные пластинки

1-й Азербайджано-Белорусская международная конференция – Баку, Азербайджан, 21-22 октября



| Соодинонио | Пос | тоянная ре | шетки |
|------------|-------|------------|-------|
| Соединение | a, Å | b, Å | c, Å |
| 7-0 | 2.240 | 2 2 4 0 | E 007 |
| ZnO | 3,249 | 3,249 | 5,207 |







ZnO:X_{0,78}

ZnO:X_{1,56}



Результаты – распределения электронной плотности и намагниченности насыщения





ZnO:Mn_{2,34}





Результаты – структура суперячеек и распределения электронной плотности

Вакансия цинка







Внедрение кислорода





Результаты моделирования границы зерна

Модель границы зерна после процесса релаксации





конфигураций дефектов сложившихся случайным образом на границе зерна.

5. Графен (G) с вакансионным кластером (nV)

Область применения: - приборы спинтроники



Графен (G) с вакансионным кластером (nV). Результаты моделирования



Зарядовые плотности и плотности электронных состояний для комплекса (G+2V)

Графен (G) с вакансионным кластером (nV). Результаты моделирования



Зарядовые плотности и плотности электронных состояний для комплекса (G+6V)

Графен (G) с вакансионным кластером (nV)

| Тип вакансионного кластера | Число вакансий в кластере | Наличие магнитного момента | Магнитный момент, µВ |
|---|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| V2 | 2 | — | 0 |
| V3 | 3 | + | 1.05 |
| V4_1 | 4 | + | 2.02 |
| V4_2 | 4 | + | 1.98 |
| V4_3 | 4 | — | 0 |
| V5 | 5 | + | 3.28 |
| V6_1 (зародыш дислокации вакансионного кластера) | 6 | + | 4.50 |
| V6_2 | 6 | + | 5.49 |

Соединения TIMeX₂ (Me=In,Ga; X= S, Se, Te)

Области применения:

- MEMC,
- солнечные элементы,
- сенсоры,
- датчики.







Электромеханические свойства системы TIMeX₂ (Me=In,Ga; X= S, Se, Te)



Зависимость спиновой поляризации от деформации сжатия и растяжения вдоль оси X или Y (слева), при всестороннем сжатии и растяжении (справа) для соединений TIMeX₂

Халькогениды переходных металлов V группы

- Переходные металлы IV- V группы
- Халькоген S, Se, Te
 Свойства:
- Полупроводники и полуметаллы
- Магнетизм (в полуметаллах)
- Волна зарядовой плотности
- Суперпроводимость Получение:
- Гидротермальный синтез
- Низкотемпературный синтез в среде алканов
- Механическое отшелушивание
- Химическое осаждение газовой фазы

| н | | - | | MX ₂ | aneitio | metal | | | | | | | | | | | |
|----|----|---------|----|-----------------|---------|-------|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|---|
| Li | Be | | | X = Cł | nalcoge | n | | | | | | в | С | Ν | 0 | F | |
| Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AI | Si | Ρ | s | CI | |
| к | Ca | Sc | ті | v | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | |
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Мо | Тс | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Те | Т | |
| Cs | Ва | La - Lu | Hf | Та | w | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | ті | Pb | Bi | Po | At | |
| Fr | Ra | Ac - Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | FI | Uup | Lv | Uus | ı |

ЧЦП Результаты моделирования MoS₂



- Ширина запрещенной зоны 1,72 эВ
- Наличие прямозонного перехода
- Отсутствие магнитных свойств

Результаты моделирования MoS₂



Проекция кристаллографической структуры TIGaS₂ с вакансионным кластером



| Размер вакансионного кластера, кол-во атомов | Е _g , эВ | Е _{спин} ,% |
|---|---------------------|----------------------|
| 1 | 1.581 | 3.455 |
| 2 | 1.580 | 3.456 |
| 3 | 1.586 | 3.456 |
| 4 | 1.586 | 6.911 |
| 5 | 1.574 | 10.366 |
| 6 | 1.612 | 12.093 |

Magnetic Random Access Memory (MRAM)



ICARUS (IC Technology Statistical Analysis based on RSM Methodology and ManUfacturability DeSign)

| Paran | ieter | Type | Min. value | Avr. value | Max, value | Deviation, 3 |
|------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| Repi | | input | 6.700E-01 | 1.173E+00 | 2.000E+00 | 56 |
| Dtr | | input | 1.500E+00 | 1.629E+00 | 1.700E+00 | 6.1 |
| Depi | | input | 7.000E+00 | 7.800E+00 | 9.000E+00 | 12. |
| Dpbody | | input | 1.800E+13 | 1.926E+13 | 2.000E+13 | 5.1 |
| 5 | | input | 2.528E+00 | 1.045E+01 | 2.700E+01 | 117 |
| VBdss | | output | 6.553E+01 | 8.920E+01 | 1.277E+02 | 34. |
| Monte-Carlo loo | p | 100000 | 3.775E+01 | 1.049E+02 | 1.891E+02 | 72. |
| Regression over | view | | | | | |
| Description | | Value | | | | |
| Residual error | | 8.385E-02 | | | | |
| Coefficient of d | etermination | 1.000E+00 | | | | |
| Adjusted coeff. | of determinat | 1.000E+00 | | | | |
| Relative averag | e residual, in p | 6.448E-02 | | | | |
| Relative maximu | im residual, in | 1.879E-01 | | | | |
| Variance ratio | | 2.098E+05 | | | | |

| View | Analysis ⊆hart | ? | | | | |
|-------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|---|
| | Real value | Appr. value | Residual | Residual, % | Std. resid. | _ |
| 1 | 6.553E+01 | 6.641E+01 | -8.821E-01 | -1.346E+00 | -4.842E-01 | |
| 2 | 6.850E+01 | 7.199E+01 | -3.494E+00 | -5.101E+00 | -1.918E+00 | |
| 3 | 7.019E+01 | 6.790E+01 | 2.291E+00 | 3.264E+00 | 1.258E+00 | |
| 4 | 6.928E+01 | 6.794E+01 | 1.344E+00 | 1.940E+00 | 7.376E-01 | |
| 5 | 7.332E+01 | 7.352E+01 | -1.985E-01 | -2.707E-01 | -1.089E-01 | |
| 6 | 8.984E+01 | 8.944E+01 | 4.019E-01 | 4.474E-01 | 2.206E-01 | |
| 7 | 8.889E+01 | 8.948E+01 | -5.854E-01 | -6.585E-01 | -3.213E-01 | |
| 8 | 9.667E+01 | 9.502E+01 | 1.650E+00 | 1.707E+00 | 9.055E-01 | |
| 9 | 1.172E+02 | 1.193E+02 | -2.181E+00 | -1.862E+00 | -1.197E+00 | |
| 10 | 1.189E+02 | 1.194E+02 | -5.084E-01 | -4.277E-01 | -2.791E-01 | |
| 11 | 1.269E+02 | 1.249E+02 | 1.977E+00 | 1.558E+00 | 1.085E+00 | |
| 12 | 6.573E+01 | 6.656E+01 | -8.296E-01 | -1.262E+00 | -4.554E-01 | |
| 13 | 6.873E+01 | 7.214E+01 | -3.412E+00 | -4.964E+00 | -1.873E+00 | |
| 14 | 7.036E+01 | 6.805E+01 | 2.313E+00 | 3.288E+00 | 1.270E+00 | |
| 15 | 6.953E+01 | 6.808E+01 | 1.446E+00 | 2.080E+00 | 7.938E-01 | |
| 16 | 7.347E+01 | 7.367E+01 | -1.961E-01 | -2.668E-01 | -1.076E-01 | |
| 17 | 9.006E+01 | 8.959E+01 | 4.743E-01 | 5.267E-01 | 2.604E-01 | |
| 18 | 8.895E+01 | 8.962E+01 | -6.729E-01 | -7.565E-01 | -3.694E-01 | |
| 19 | 9.701E+01 | 9.517E+01 | 1.842E+00 | 1.899E+00 | 1.011E+00 | |
| 20 | 1.174E+02 | 1.195E+02 | -2.069E+00 | -1.762E+00 | -1.136E+00 | |
| | Good 📃 Nor | mal 📃 Eno | ugh 📃 Bad | | | |
| Globa | al overview Prei | iminary analysis | Polynom coeffi | ient Approxima | ation result | |

| ~ | Design of Ex Please, seler | cperiment select ct one of Design of | tion Experiment | | | 7.51 |
|---|--|---|--|--|--|--|
| elect plan | Full Factor plan | ✓ ^{Sele} | ct plan view Norma | lized | ~ | Copy to clipboard |
| | dose (0026-1) | temp (0036-1) | energy (0038-2) | temp (0048-1) | time (0036 | -0) |
| 5tep 000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 5tep 001 | -1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| 5tep 002 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| 5tep 003 | -1.0 | -1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| 5tep 004 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | | |
| 5tep 005 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | | |
| | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | × |
| Full factor A design in design. A c called `higl input factor if there are | rial designs which every settir common experime h' and `low' or `+1 rs is called a full fa k factors, each at | ng of every factor : ntal design is one L' and `-1', respect ictorial design in tv : 2 levels, a full fac | appears with every s with all input factors ively. A design with a vo levels. torial design has 2 ^k r | etting of every oth set at two levels e Il possible high/lov uns. | er factor is a f ach. These le r combination | full factorial vels are s of all the |
| | Number | of Factors | | Numbe | r of Runs | |
| | | 2 | | | 4 | |
| | | | | | | |
| | | 3 | | | 8 | |

Finish

<- Previous





Высокотемпературный диод Шоттки

Определение границ тепловой устойчивости диода Шоттки в диапазоне указанных параметров эпитаксиального слоя и высоты барьера Шоттки при номинальном обратном напряжении.





Materials:

Aluminum

Silicon

Высокотемпературный диод Шоттки



ВАХ диода Шоттки при температуре 27 °C

Распределение напряженности электрического поля в структуре диода Шоттки при напряжении на катоде 18 В



Моделирование воздействия ионизирующего излучения на характеристики МОП-транзистора



Полевой транзистор под воздействием отдельной ядерной частицы

Распределение концентрации дырок в структуре мощного МОП-транзистора в момент времени t = 0 c (a), t = $5 \cdot 10^{-12}$ c (б), t = $50 \cdot 10^{-12}$ c (в), t = $150 \cdot 10^{-12}$ c (г)



Моделирование воздействия ионизирующего излучения на характеристики МОП-транзистора

Моделирование воздействия ионизирующего излучения на характеристики МОП-транзистора



Динамика изменения тока стока при воздействии частицы с линейной передачей энергии равной 37,2 МэВ·см²/мг, проходящей в центре устройства (x = 0). В момент удара напряжение на затворе равно -13,9 В, на коллекторе 30В.

Моделирование TSV-структур



Динамика изменения тока стока при воздействии частицы с линейной передачей энергии равной 37,2 МэВ·см²/мг, проходящей в центре устройства (х = 0). В момент удара напряжение

на затворе равно -13,9 В, на коллекторе 30В.

Моделирование TSV-структур

- TSV формировались в объеме кремния размерами 10 мкм x 10 мкм x 5 мкм.
- На подложку осаждался нитрид кремния толщиной 0,1 мкм.
- В осажденном слое нитрида кремния создается маска для последующей операции травления.





Моделирование TSV-структур





Образовательные модули на основе технологии SCORM



E-RUDIT (Educational RUDder via Internet Technology)

 $\overline{\mathbf{A}}$ СОДЕ

> Препо Стем доб

троники

| ГЛАВНАЯ НОВОС | СТИ БЛОГ О СИСТЕМ | е контакты | | |
|---------------|---------------------------------------|---|----------|---------|
| E-RUDIT | еда для организации и ко | троля качества учебного процесса» | | |
| Меню | Осис | теме | | |
| Новости | | Программно-аппаратный комплекс | | |
| о Системе | | E-RUDIT (<u>E</u> ducational <u>RUD</u> der via <u>I</u> nternet <u>T</u> echnology) | | |
| Контакты | «Инт процесса» | ернет-среда для организации и контроля качества учебного | | |
| Вход на сайт | Комп | екс предназначен: | | |
| Ваш логин: | 1 E-RUD | т | ПРОФИЛЬ | ROOT |
| Ваш пароль: | СОДЕРЖАНИЕ САЙТА СТРУКТУРА ВРЕМЯ З | КУРСЫ РАСПИСАНИЕ КОНТРОЛЬ БЛОГ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ДОСТУП | НАСТРО | йки |
| Войти | меню | □ ТИП НАЗВАНИЕ ▼ СОКР. | КОД РЕД. | удалить |
| | ДОБАВИТЬ СПЕЦЬНОСТЬ | Начало / Радиоэлектроники / Микро- и наноэлектроники | | |
| | | Специальность Квантовые Информационные Системы КИС | 270 | |
| | поиск | Специальность Микро- и наноэлектроники МНЭ | 030 📝 | |
| | | 2 M3 2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| L | | | | |

| E CANTA | КУРСЫ Р | АСПИСАНИЕ | KOH | гроль | ыю | польз | ВОВАТЕЛИ | досту | | | | | | |
|---------|---|--|---|-------------------------------------|---|---|--|--|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| РАСПИСА | АНИЕ | | | | | | | | | | | | | |
| | ДЕНЬ | неделя | 11 | | НЕДЕЛЯ 2 | | недел | 13 | | НЕДЕЛЯ 4 | | | | |
| 3. P. 🔽 | ПОНЕДЕЛЬНИК | 8:00-9:35 - ИТ (Лекции) Группы: 740301, Аудитория: 119- | аПИМ 740302 1 Ш | | | | | | | | | | | |
| | вторник | 11:40-13:15 - ¥ (Практические Группы: 542701 13:25-15:00 - ¥ (Практические Группы: 542701 | твпим) Пвпим)) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| C(| одержание с | RUDIT :айта кур | сы | РАСПИС | АНИЕ | КОНТРО | ль бло | г поль | 30BAT | ели Д | цосту | пр П НА | офиль СТРОІ | ROC вых |
| СС | одержание с | RUDIT :айта куг | РСЫ ИП ВСЕ | РАСПИС | АНИЕ | КОНТРО АНИЕ — | ль бло | Г ПОЛЬ ПРЕПОДА | оЗОВАТ ВАТЕЛИ | ЕЛИ Д | цостуі часы | пр П НА ФАЙЛЫ | офиль СТРОІ РЕД. | ВЫХ ВЫХ ЙКИ УДАЛИТ |
| | СДЕРЖАНИЕ С СДЕРЖАНИЕ С ЕНЮ НОВЫЙ ДОБАВИТЬ | | СЫ I ИП ВСЕ | РАСПИС | АНИЕ НАЗВ Инфо техно. проек интег | КОНТРО АНИЕ - рмационны логии в тировании ральных м | ЛЬ БЛО | Г ПОЛЕ ПРЕПОДА Стемпицки Нелаев В | 30ВАТ ВАТЕЛИ ИЙ В. Р., . В . | ЕЛИ , группы 740301 740302 | цосту часы 50 | пр П НА ФАЙЛЫ <u>1</u> 9 | офиль СТРОІ РЕД. | КО Вых Удалит |
| | СССРЕДСТВИИ СОДЕРЖАНИЕ С ЕНКО НОВЫЙ ДОБАВИТЬ УДАЛИТЬ | ANTA KY | ип все Лекци | РАСПИС и заторные | назв. Инфо техно. проек Интел Инфо техно. проек Интел | КОНТРО Ание • риационне погии в тировании ральных ми риационне погии в таровании ральных ми | ль БЛО | ПОЛЕ ПРЕПОДА Стемпицки Стемпицки | аЗОВАТ ватели ий В. Р., . В. ий В. Р. | ЕЛИ , ГРУППЫ 740301 740301 742701 742701 | часы 50 | пр п на файлы 10 20 | офиль СТРОІ РЕД. | КОС Вых ЙКИ Удалит |
| | С С С С С С С С С С С С С С С С С С С | | сы и ип все Лекци Лабор Практ | РАСПИС ии заторные ические | АНИЕ назв. Инфо техно проек Инфо Техно проек Инфо техно проек Инфо | КОНТРО АНИЕ • риационне потии. в тировании альных и риационне потии. в тировании альных и риационне потии. в тировании альных и ральных и риационне ральных и риационне ральных и риационне риационне риационне риационне риационне риационне риационне риационне риационне ритирании ральных и риационне ритирании | | ПОЛЕ препода Стемпицка Стемпицка Стемпицка Нелаев В. | •ЗОВАТ ватели ий В. Р., ий В. Р. ий В. Р. В. | ЕЛИ / ГРУППЫ 740301 740302 742701 740301 542701 | часы 50 12 16 | пр п на файлы 1 ⁰ 2 ⁰ | офиль СТРОІ РЕД. С | КОС ВЫХ УДАЛИТ Со |
| | СДЕРЖАНИЕ С ВНЮ НОВЫЙ ДОБАВИТЬ УДАЛИТЬ ПОИСК | RUDIT | сы ил все Лекци Лабор Практ З | РАСПИС ии жаторные ические | АНИЕ Инфо техно проек Интел Инфо техно проек Интел Инфо техно проек Интел | КОНТРО АНИЕ риационны потии в тировании ральных мі риационны риационны риационны потии в тировании ральных мі | ль бло меросхем меросхем меросхем ме | Г ПОЛЕ ПРЕПОДА Стемпицка Нелаев В Стемпицка Нелаев В. | аЗОВАТ ватели ий В. Р., ий В. Р. ий В. Р. в. | ЕЛИ / ГРУППЫ 740301 740302 742701 740301 740301 542701 | цостун часы 50 12 16 | пр П НА ФАЙЛЫ 10 00 00 00 | офиль СТРОІ РЕД. | КОС ВЫХ УДАЛИТ Со |
| | СССРЖАНИЕ С СОДЕРЖАНИЕ С СНО НОВЫЙ ДОБАВИТЬ УДАЛИТЬ ПОИСК | RUDIT | РСЫ ип все Лекци Лабор Практ З | РАСПИС и раторные ические | назв. Инфо Техно, проек Интет Инфо Техно, проек Интет | КОНТРО АНИЕ | ль бло ме икросхем меросхем | полн препода Стемпици Нелаев В Стемпици Нелаев В. | азоват ий В. Р., в. В. ий В. Р. ий В. Р. | ЕЛИ / ГРУППЫ 740301 740301 742701 740301 542701 542701 | часы 50 12 16 | пр п на файлы 1 2 2 2 2 | офиль СТРОІ РЕД. С | ROC |



- 220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 6, ауд. 119
- Стемпицкий Виктор Романович
- □ e-mail: *vstem*@bsuir.by
- □ Web: *http://bsuir.by*
- □ Телефон: +375 (17) 293-88-90